

10.3 Vinculación del programa de Maestría En Ciencias En Ingeniería Electrónica.

El proceso de vinculación promueve que las funciones sustantivas de docencia, investigación y vinculación generen respuestas tecnológicas que incidan en soluciones a las problemáticas nacionales con la participación de profesores, investigadores y estudiantes del programa de posgrado en Ingeniería Electrónica del IT Morelia que atienden programas institucionales internos, programas externos, y convocatorias relacionadas con la investigación científica, la innovación y el desarrollo tecnológico.

10.3.1 Objetivo de la vinculación.

El programa de Maestría En Ciencias en Ingeniería Electrónica reconoce a la vinculación como una actividad sustantiva de la docencia y la investigación para enfocar los esfuerzos en investigación y desarrollo tecnológico para impactar positiva y continuamente en el entorno de acuerdo con las necesidades de desarrollo regional y nacional integrando constantemente retroalimentación de la realidad productiva al quehacer académico.

10.3.2 Convenios gestionados por el programa de Maestría en Ciencias en ingeniería Electrónica.

El programa MCIE mantiene una actividad dinámica en vinculación. El 12% de los convenios institucionales en el periodo de evaluación, han sido gestionados por el programa MCIE (Figura 5).

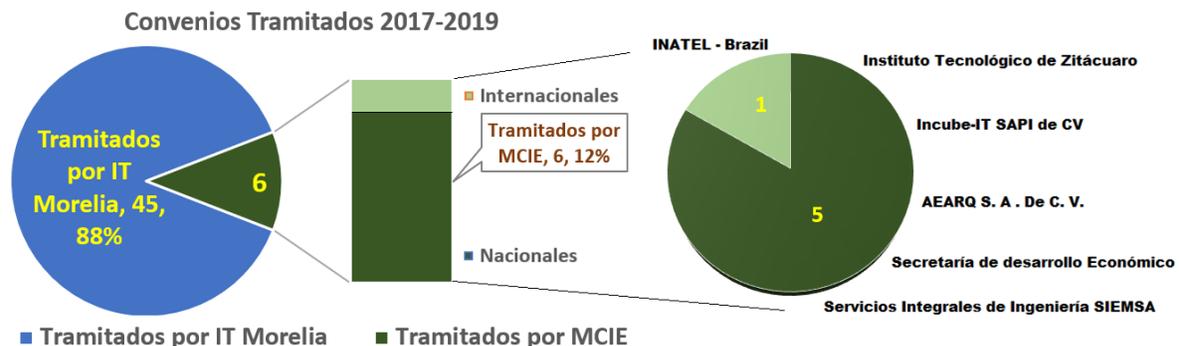


Figura 5. Convenios del IT Morelia (2017-2019) y convenios gestionados por el programa MCIE

Los convenios de colaboración o para la prestación de servicios externos, tramitados por el programa MCIE corresponden a 1 convenio internacional y 5 convenios nacionales que incluye IES, Gobierno, sector productivo e Innovación.

10.4 Gestión de proyectos de investigación

La misión del programa MCIE en actividades de investigación está orientada a impactar en los sectores estratégicos para el desarrollo nacional, así como servicios a la industria. Durante el periodo de evaluación el financiamiento obtenido asciende a \$ 10,990,597.00 en 20 proyectos de investigación: 14 proyectos de la LGAC Procesamiento de señales (Figura 6) y 6 Proyectos de la LGAC de Electrónica de Potencia (Figura 7)

**Proyectos Financiados
LGAC Procesamiento de Señales**

■ 2016-2017 ■ 2016-2018 ■ 2017-2018 ■ 2017-2020 ■ 2018-2019 ■ 2019-2019



Figura 6. Proyectos financiados (LGAC Procesamiento de Señales)

**Proyectos Financiados
LGAC Electrónica de Potencia**

■ 2017-2018 ■ 2018-2018 ■ 2018-2019 ■ 2019-2019

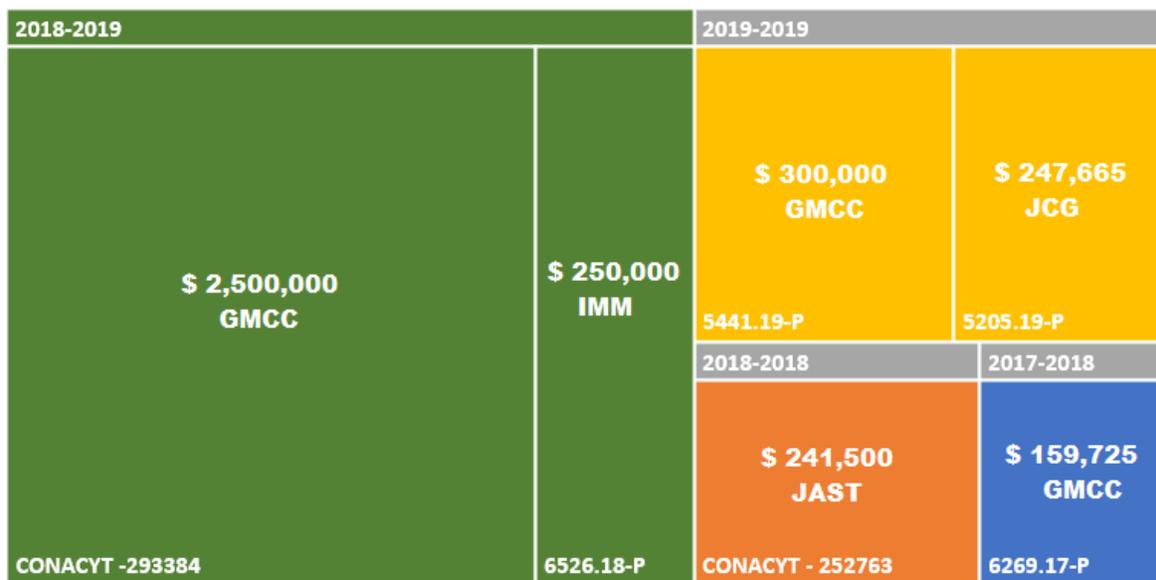


Figura 7. Proyectos financiados (LGAC Electrónica de Potencia)

10.5 Productos en vinculación

Los productos obtenidos de las acciones en vinculación incluyen presentaciones y publicaciones en extenso en congresos internacionales y artículos en revistas indizadas, solicitudes de patente y registro INDAUTOR en los proyectos de ambas LGCA, como resultado de investigación científica y desarrollo tecnológico. Es importante mencionar que los productos le dan crédito a la participación de estudiantes y profesores.

10.5.1 Productos LGAC Procesamiento de señales.

El 95% de los productos de vinculación de la LGAC Procesamiento de señales involucra principalmente IES, Instituciones de investigación, Instituciones Gubernamentales, nacionales e internacionales y el 5% con empresas (Figura 8).

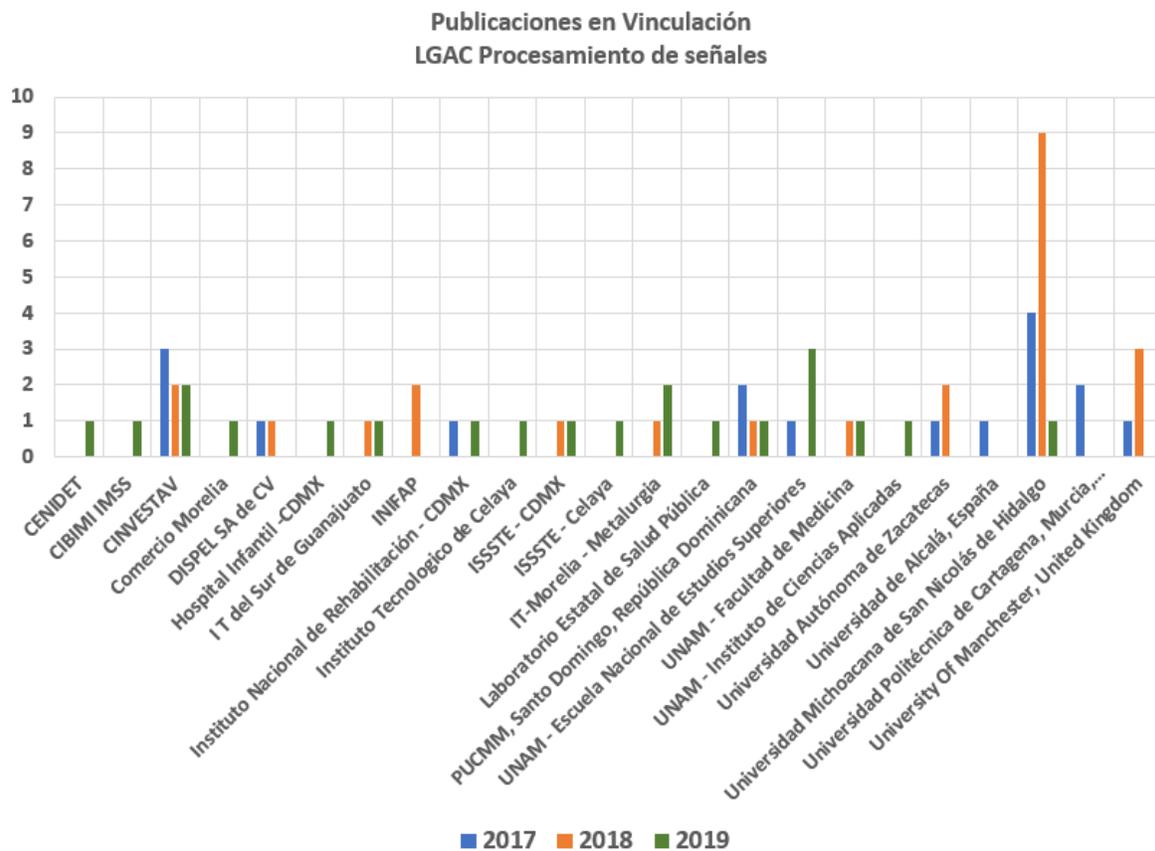


Figura 8. Relación de productos en vinculación de la LGAC Procesamiento de Señales por institución/empresa vinculada.

Las actividades de vinculación resultaron en 62 productos de los cuales el 18% (11 productos) se realizó en vinculación internacional (Figura 9).

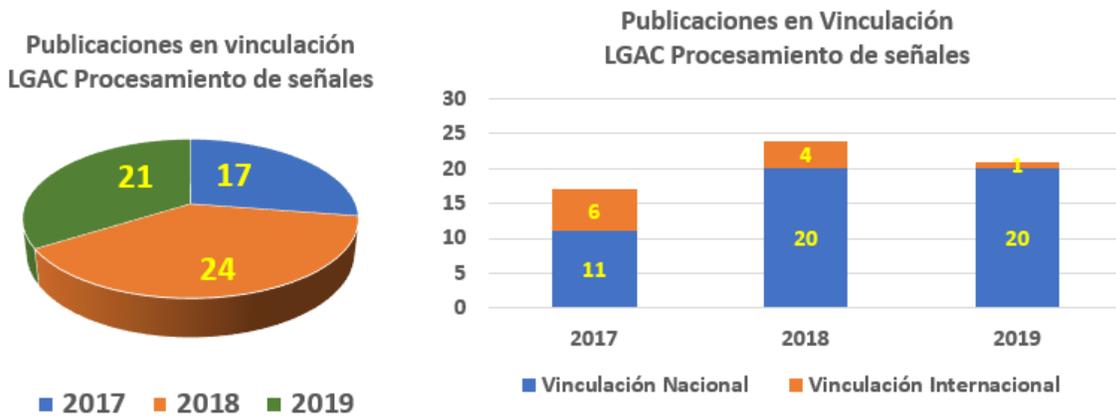


Figura 9. Relación de productos por año de la LGAC Procesamiento de Señales.

10.5.2 Productos LGAC Electrónica de Potencia

El 61% de los productos de vinculación de la LGAC Electrónica de Potencia involucra principalmente IES, Instituciones de investigación, Instituciones Gubernamentales, nacionales e internacionales y el 39% con empresas (Figura 10).

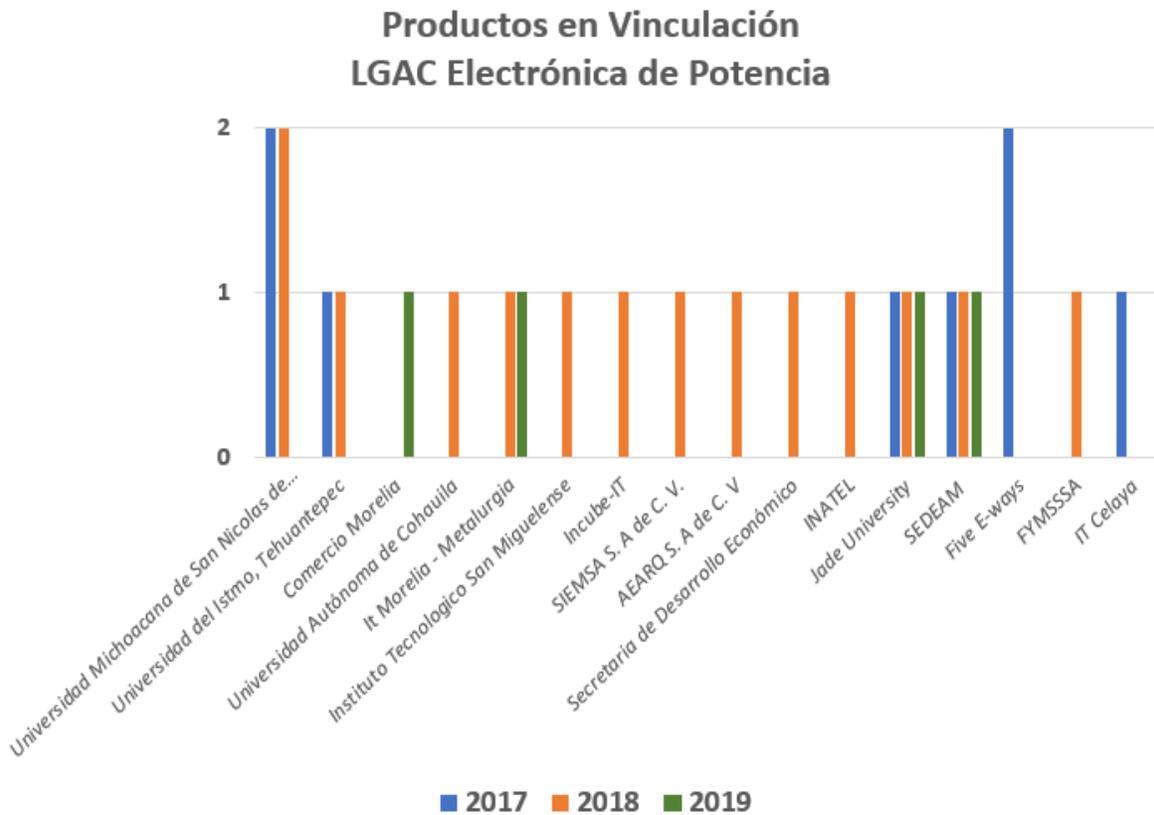


Figura 10. Relación de productos en vinculación de la LGAC Electrónica de Potencia por institución/empresa vinculada.

Las actividades de vinculación resultaron en 26 productos de los cuales el 15% se realizó en vinculación internacional (Figura 11).

**Publicaciones en vinculación
LGAC Electrónica de Potencia**



**Publicaciones en vinculación
Electrónica de Potencia**

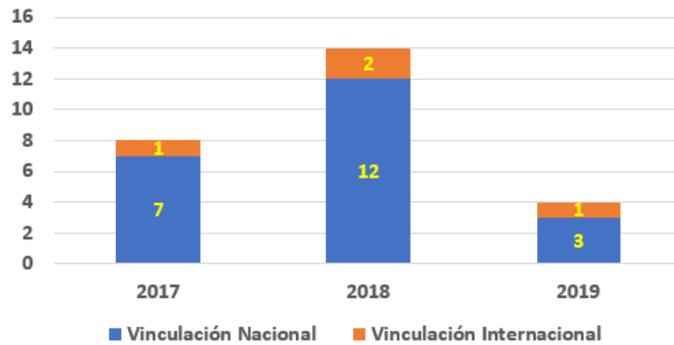


Figura 11. Relación de productos por año de la LGAC Electrónica de Potencia

10.6 Estancias nacionales e internacionales

Las actividades de vinculación permitieron realizar intercambios, para estudiantes y profesores, para la realización de actividades de investigación (Figura 12).

- i. 8 Estancias e intercambio internacional para profesores: 3 en Jade University, Alemania (GMCC), 4 en University of Manchester, Reino Unido (JAGG) y una visita del investigador Wuqiang Yang (University of Machester).
- ii. 1 Estancia nacional de profesor: Instituto Tecnológico de Celaya (JCG)
- iii. 3 Estancias Internacionales (estudiantes): INATEL, Brasil (Oscar Lobato Nostroza), Osben Francisco Cándido Sánchez (University of Manchester, UK) y Héctor Martínez Domínguez (University of Oxford, UK).
- iv. 2 Estancias Nacionales. Recepción de dos estudiantes trabajando en el proyecto CONACYT 277688 del Instituto Tecnológico del Sur de Guanajuato (Luis Ismael Pintor Lázaro) y de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Julieta Guadalupe Rodríguez Ruiz).

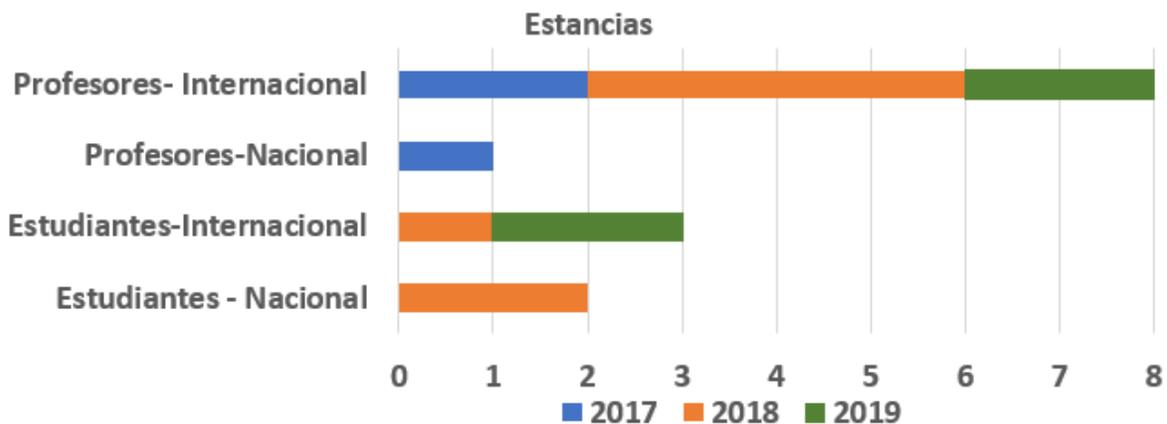


Figura 12. Estancias de estudiantes y profesores (nacionales e internacionales).

10.7 Bolsa de trabajo

Además de las acciones de vinculación directa del programa, los estudiantes tienen acceso a la bolsa de trabajo que se gestiona por el Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación (Figura 13).

BOLSA DE TRABAJO

Inicio | Ingresar tu CV | Ofertas de Empleo | Prácticas Profesionales | Contacto

Hemos seleccionado las **MEJORES** ofertas laborales para ti

Búsqueda de Empleo Seleccione Ciudades [Búsqueda Avanzada](#)

Ofertas Exclusivas

[Ofertas Exclusivas](#) | [Ofertas Externas de Empleo](#) | [Prácticas Profesionales](#) | [Empleo Internacional](#)

Fecha	Puesto	Organización	Vacantes	Estado
Su búsqueda no ha arrojado resultados, pruebe con otros datos.				
Ofertas Externas de Empleo				
Fecha	Puesto	Organización	Vacantes	Estado
28/11	INGENIERO CALCULISTA ESTRUCTURAL	CONFIDENCIAL	2	Estado de México
28/11	INGENIERO DE DISEÑO ESTRUCTURAL	SEIS-MEX	2	Baja California Sur
28/11	Auxiliar de crédito y cobranza - Telecomunicaciones	IENTC S DE RL	3	Querétaro
28/11	Ingeniero de Soporte Técnico N1 - Telecomunicaciones	IENTC S DE RL	2	Querétaro
25/11	RESIDENTE	EDIFICADORA PROMOTORA E INVERSIONISTAS	2	Estado de México
20/11	SUPERVISOR DE OBRA ELECTROMECAÁNICA	GEOSOL	1	Ciudad de México
20/11	INGENIERO DE CONTROL DOCUMENTAL Y ESTIMACIONES	GEOSOL	2	Ciudad de México
20/11	SUPERVISOR DE PAVIMENTOS	GEOSOL	3	Ciudad de México
20/11	Ingeniero Jr	HMK ISM, S.A. de C.V.	1	Ciudad de México
20/11	DIBUJANTE	IPESA	1	Ciudad de México
15/11	INGENIERO O ARQUITECTO	CONSULTORES EN ARQUITECTURA Y DISEÑO CAD, S.A. DE C.V.	1	Ciudad de México
15/11	Contador Público	CONSULTORES EN ARQUITECTURA Y DISEÑO CAD, S.A. DE C.V.	1	Ciudad de México
14/11	SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN	GRUPO GIIP	1	Ciudad de México
14/11	GERENTE DE PROYECTO (USOS MIXTOS)	GRUPO GIIP	1	Guanajuato
14/11	GERENTE DE PROYECTO (VIVIENDA)	GRUPO GIIP	1	Jalisco
13/11	PRACTICANTE DE R&D (CINSA)	CINSA	1	Coahuila
13/11	INGENIERO CIVIL CON DOCTORADO EN MECÁNICA DE SUELOS	CONFIDENCIAL	1	Ciudad de México
13/11	INGENIERO CIVIL CON MAESTRIA EN MECÁNICA DE SUELOS	CONFIDENCIAL	1	Ciudad de México

1 [2](#) [3](#) [4](#) [Siguiente »](#)

Figura 13. Bolsa de trabajo gestionada por el Depto. de Gestión Tecnológica y Vinculación